

목 차

주주총회 소집 공고.....	1
주주총회 소집 공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	4
III. 경영참고사항	5
1. 사업의 개요.....	5
가. 업계의 현황	5
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	12
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	12
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	18
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	19
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	19

주주총회소집공고

2015 년 3 월 12 일

회 사 명 : (주)텔레칩스
대 표 이 사 : 이 장 규
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터회관)
(전 화) 02-3443-6792
(홈페이지)<http://www.telechips.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 장 규
(전 화) 02-3443-6792

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

1. 일시 : 2015년 3월 30일(월), 오전 9시

2. 장소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터회관)
지하1층 베네치아 음식점

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고

나. 제15기 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)
 - * 제2-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건 (재선임)
 - * 제2-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건 (신규선임)
 - * 제2-3호 의안 : 사내이사 장창희 선임의 건 (신규선임)
 - * 제2-4호 의안 : 사외이사 Martin Manniche 선임의 건 (신규선임)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제16기 배당은 현금배당 14%(액면가 500원 기준)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			고성규 (출석률: 66.7%)
			찬 반 여 부
1	2014.01.27	<ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (주요내용) - 변경전 : 대표이사 서민호(대표이사 및 등기이사 사임) - 변경후 : 대표이사 이장규(신임) 	참석/찬성
2	2014.02.13	<ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (주요내용) 1) 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 	불참
2	2014.03.07	<ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정의 건 (주요내용) 1) 소집일시 : 2014년 3월 28일 오전 9시 2) 소집장소 : 서울시 송파구 신천동 7-20, 루터회관 지하1층 베네치아 예식장 3) 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 <ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 	참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 아니하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 산업의 특성

당사가 속한 팹리스 반도체 산업은 반도체 제조공장(Fab : fabrication facility)을 세우고 유지하기 위한 비용이 수조원에 이르기 때문에 제조부분을 분리하여 외부 전문업체에 아웃소싱함으로써 설비투자 위험을 회피하고 부가가치가 높은 제품기획, 회로설계 및 마케팅에 역량을 집중하여 능률을 극대화 하려는 의도에서 출현하였습니다.

최근 특정분야의 시장지배자로 성장한 일부 팹리스 반도체 회사는 Fab에 대한 통제력까지 가지게 되어 종합 반도체 회사와 대등한 경쟁을 할 정도로 발전하였으며, 또한 종합 반도체 회사도 Fab의 규모를 줄이고 특정분야의 반도체 제품개발에 집중하는 등 기업가치를 제고하기 위한 시도가 계속되고 있습니다.

팹리스 반도체 산업의 일반적인 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 팹리스 반도체 회사의 가장 큰 특징은 제품의 생산을 외부 전문업체에 위탁하고 자신의 제품을 기획하고 설계하여 자신의 계획과 책임하에 판매하는 점이라고 할 수 있습니다. 팹리스 회사는 자신의 핵심역량을 제품개발과 마케팅에 집중함으로써 여타 반도체 업체보다 능률적인 기업구조를 가지고 있다는 것입니다.

둘째, 막대한 자금이 소요되는 반도체 생산설비(Fab)를 보유하지 않음으로써 설비투자 위험을 회피할 수 있다는 것입니다.

셋째, 팹리스 반도체 산업은 고도의 지식집약산업으로서 핵심 설계기술을 기반으로 제품 경쟁력을 갖춘 미국, 유럽, 대만 등 반도체 선진국의 업체가 세계시장을 장악하고 있습니다.

당사는 팹리스 반도체 회사로서 어플리케이션 프로세서(Application Processor, 이하 AP라 한다)를 포함한 멀티미디어칩과 T-DMB, ISDB-T, DVB-T/H 등 다양한 모바일 방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 등의 제품포트폴리오를 구축하고 있으며, 다양한 응용분야로 이들 제품을 판매하고 있습니다.

현재 당사의 제품이 적용되고 있는 주요한 응용분야는 다음과 같습니다.

☐ Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등)

당사는 셋톱박스(Set Top Box, 이하 STB라 한다), 네비게이션(Portable Navigation Device, 이하 PND라 한다), 차량용 블랙박스(Automotive Black Box, 이하 Black Box라 한다), 태블릿 PC(Tablet PC, 이하 Tablet이라 한다) 등 다양한 소비자 전자제품(Consumer Electronics)에 멀티미디어칩 및 모바일 TV 수신칩을 공급하고 있습니다.

☐ Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등)

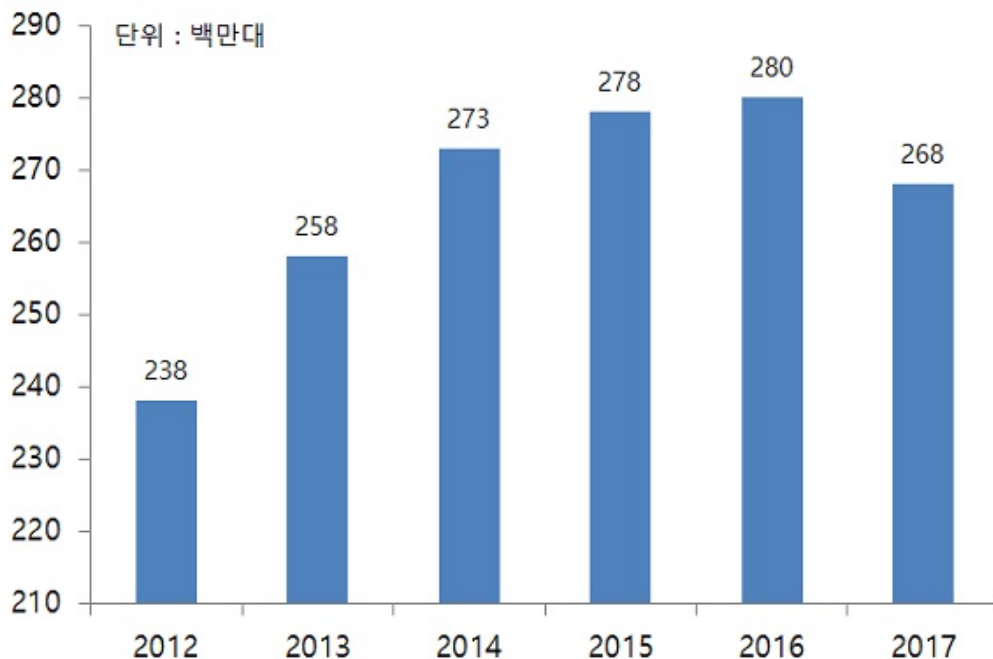
당사는 차량용 오디오(Car Audio) 및 네비게이션 등의 전장 제품에 멀티미디어칩 및 모바일 TV 수신칩을 공급하고 있습니다.

한편, 당사를 비롯한 팹리스 기업의 경우 일반적인 팹리스 산업환경에 의한 영향 보다는 주요 제품이 적용되는 응용제품이 속한 산업 환경에 의해서 직접적인 영향을 받고 있으므로, 이후에는 당사가 제품을 적용하는 상기의 응용분야를 중심으로(Consumer Electronics 부문은 STB를 중심으로) 사업의 개요를 기술하고자 합니다.

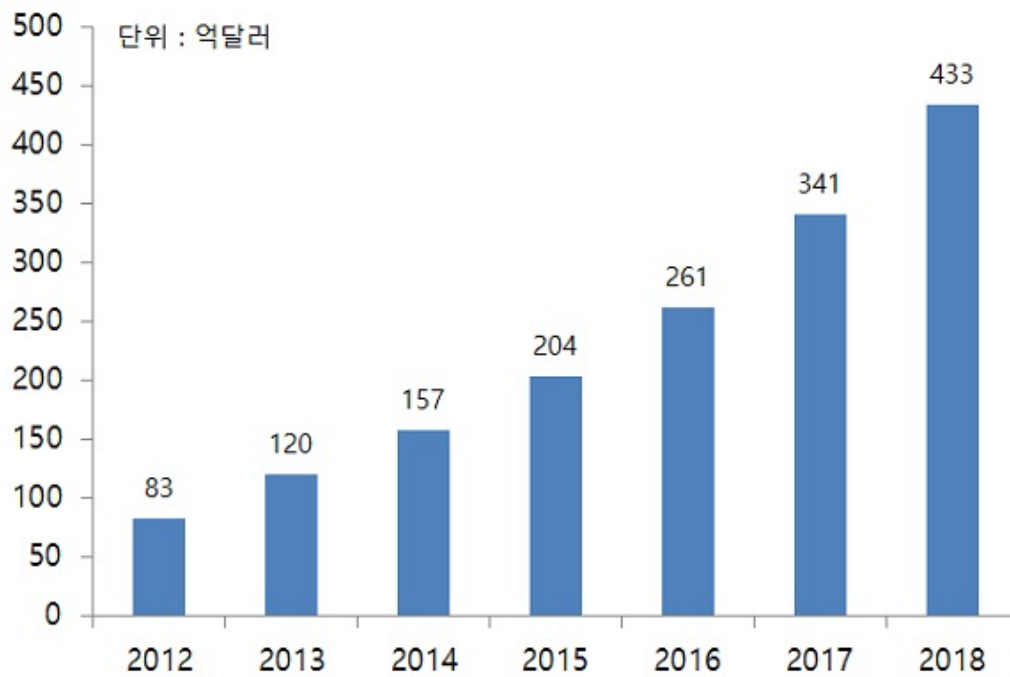
(나) 성장성

□ Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등)

STB 시장은 스마트 디바이스를 통한 비디오 소모가 활발해졌음에도 불구하고 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 이러한 추세는 2016년까지 유지되다가 2017년에 일부 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, STB 시장은 OTT Box(Over The Top Box, 이하 OTT 라 한다)와 스마트 TV 등과 경쟁하면서 시장 성장이 점차 정체될 것으로 예상됩니다. 그러나 UHD(Ultra High Definition) 방송 보급 확대와 개발도상국을 위주로 지상파의 디지털 전환이 시작된다는 점은 셋톱박스 시장의 새로운 기회로 작용할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

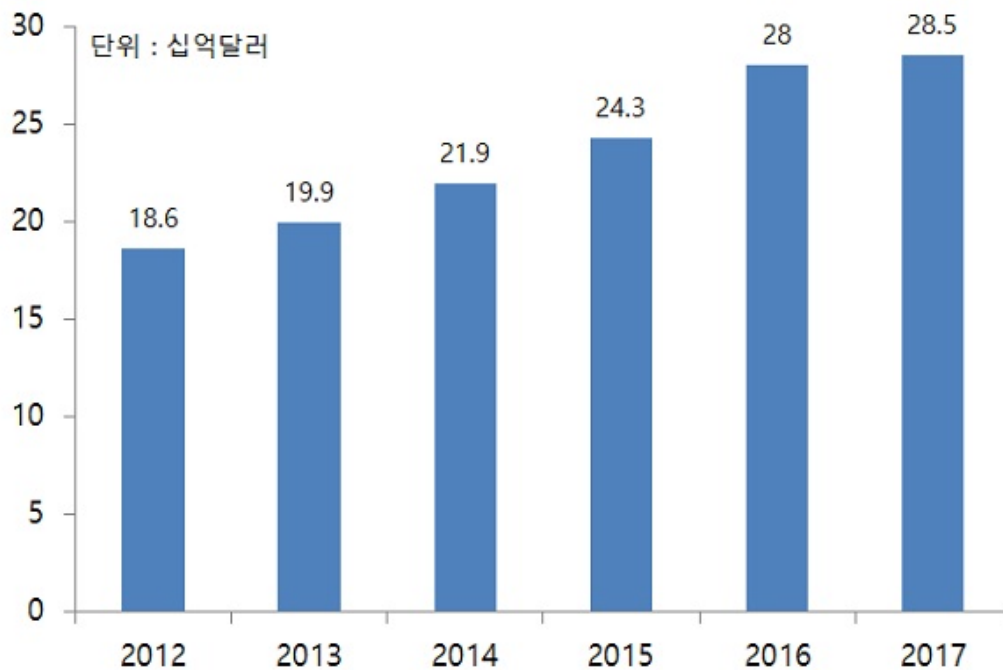


한편, 넷플릭스와 아마존, 유튜브 등 OTT 온라인 스트리밍 서비스가 전통적인 유료 TV 방송사를 위협할 수준으로 성장하고 있으며, 미국 전체 가구의 32%는 유료 TV 가입 가구이며 27%는 온라인 스트리밍 서비스를 이용하는 것으로 조사되는 등 현재의 온라인 스트리밍 서비스 시장의 성장세를 보았을 때 조만간 유료 TV 시장을 능가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 OTT 이용자는 2013년 12억명에서 2018년 19억명으로 성장하고 매출 규모 측면에서는 2013년 120억 달러 규모에서 2018년 433억 달러로 큰 폭의 매출 상승이 예상됩니다.



□ Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등)

자동차와 IT기술의 접목이 가속화되면서 차량용 반도체 시장 또한 날로 성장을 거듭하고 있습니다. 차량용 반도체 시장은 2012년 186억 달러에서 2013년 199억 달러로 7% 성장하였으며 2015년에는 243억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다.



특히, 차량용 Audio, Infotainment&Driver Information Head Unit 은 각종 멀티미디어 기능 및 외부 Interface 의 강화에 따라서 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

[차량용 Audio, Infotainment&Driver Information Head Unit 시장 전망]

(단위 : 백만대)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013F	2014F	2015F
Head Unit	84.7	89.4	98.7	103.3	108.2	114.0	124.4
성장률(%)	-	5.6	10.4	4.7	4.7	5.4	9.1

자료) IMS Reseach, December 2010

(다) 경기변동의 특성 및 계절성

각종 Consumer Electronics(STB/PND/Black Box/Tablet 등), 스마트폰, 차량용 전자부품 등의 경우 새로운 기술 및 기능의 채용에 따른 시장요구의 변화가 매우 빠른 속도로 전개되고 있어 이러한 변화에의 적응이 경기변동상의 영향을 최소화 하는데 매우 중요한 요인이 되고 있습니다.

특히, 디지털 STB 시장의 경우 일반적인 경기의 영향과 함께 다른 IT 산업과 유사한 계절적 경기 변동 추이를 보이며, 연말 성수기 이후 연초까지 증가세를 보이다가 주요 수요국가인 유럽 및 중동지역의 휴가철인 5~6월경부터 수요가 감소하는 양상을 나타냅니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황, 시장점유율 추이

(가) 시장의 안정성 및 경쟁상황

메모리 반도체 시장이 한발 앞선 미세공정 적용과 시장수요 및 업체간 공급량 조정때문에 가격이 형성이 됨으로써, 대규모 설비투자 능력을 보유한 업체간의 과점적 경쟁체계를 형성하고 있는데 비해서 비메모리 반도체 시장의 경우에는 주로 신기술이나 신제품이 적용되는 초기시장 형성단계에서는 독점적 또는 과점적 경쟁체계를 형성하게 되지만 전방시장의 급속한 성장과 함께 많은 기업들이 새롭게 시장에 진입하기 시작하면서 점차 경쟁시장체계를 띄게 됩니다.

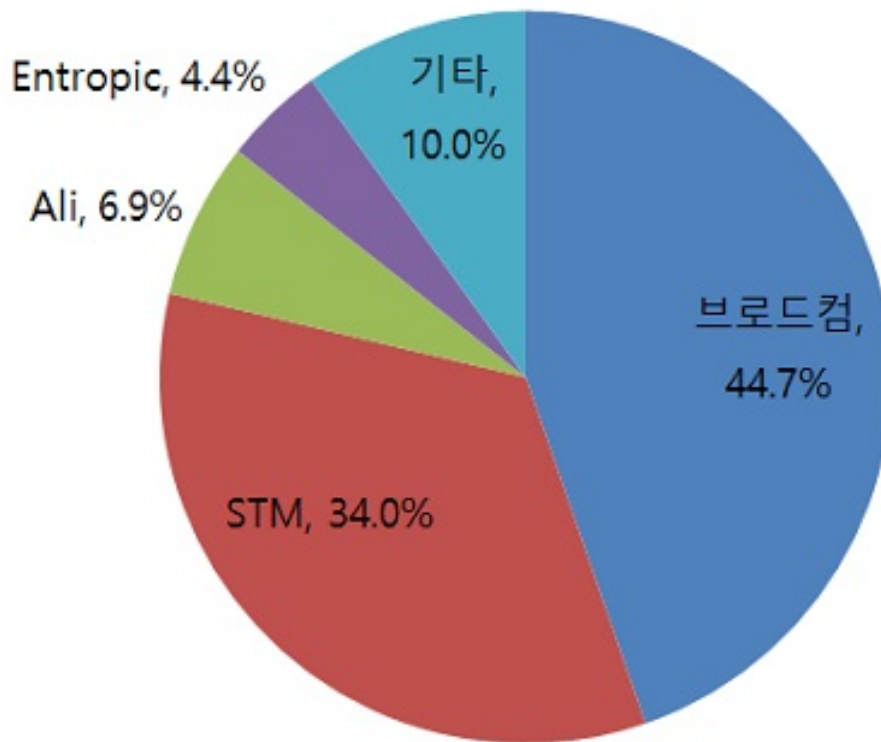
특히, 반도체 산업의 경우에는 각종 첨단기술의 접목으로 기능이 점차 향상됨에도 불구하고 시간이 경과함에 따라서 가격이 오히려 하락하는 IT산업이 안고 있는 기술혁신과 가격 사이의 역설로 인하여 끊임없이 신제품과 신기술 개발을 하여야 한다는 어려움을 갖고 있습니다. 이에 더하여 팹리스 기업의 경우에는 자체 공장과 대규모 연구개발투자능력 그리고 훨씬 더 우수한 영업망을 갖춘 종합반도체회사(IDM)에 비해가격적인 측면에서 열세에 놓일 수 밖에 없는 근본적인 핸디캡마저 안고 있는 상황입니다.

따라서, 팹리스 기업이 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위해서는 기술표준의 선점이나 핵심 IP확보를 통해 특정분야에 기술진입장벽을 구축하거나 종합반도체회사에 비해 열세인 생산부분의 경쟁력 확보를 위하여 파운드리(Foundry) 회사와 유기적인 협업체계를 구축하는 등의 노력이 무엇보다 필요합니다.

(나) 시장점유율 추이

□ Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등)

전 세계 STB용 Main SoC 시장은 브로드컴과 ST마이크로가 주도하고 있으며, 양사 매출액 점유율 합계는 80%에 이르고 있습니다.

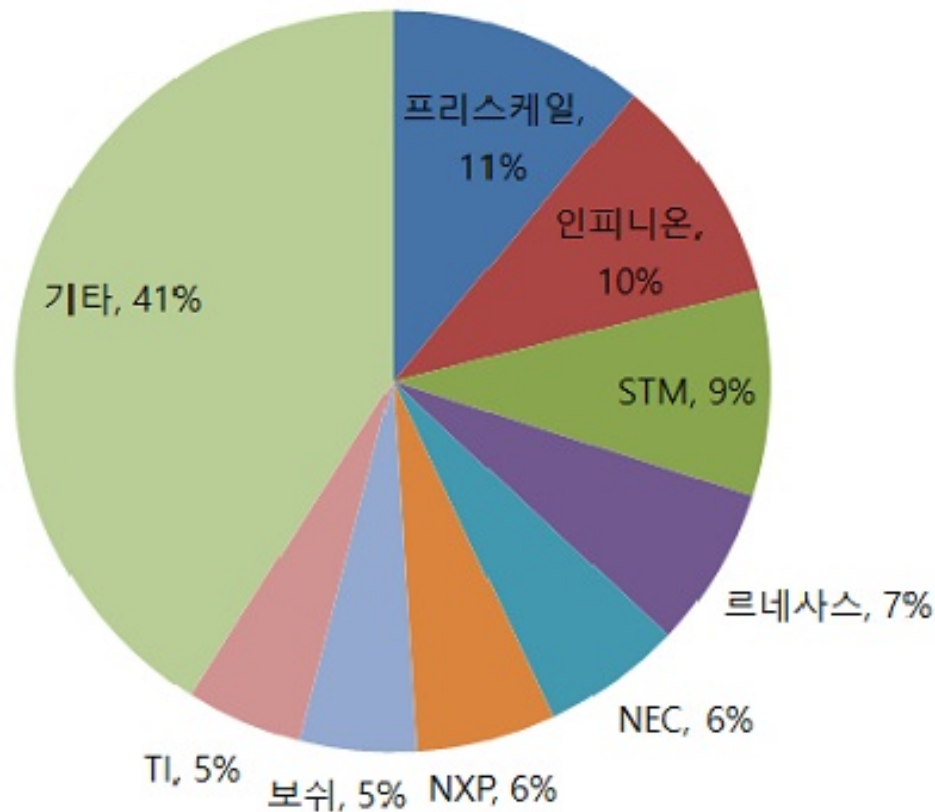


한편, 인터넷 콘텐츠 스트리밍 서비스인 OTT 서비스와 기존 IPTV 또는 CATV와 OTT가 결합된 스마트 셋톱박스가 확산되면서 최근 칩셋 업계에도 변화가 감지되고 있습니다. STB 시장의 전통적인 강자인 브로드컴, ST마이크로를 위협하는 중소 칩 업체들이 등장하고 있고 코어 프로세서도 MIPS가 아닌 ARM 코어 비율이 증가하고 있는 있으며, 마벨, 당사 등 국내외 AP 업체가 신규로 진입하고 있습니다.

당사는 최근 수년간에 걸쳐서 STB용 Main SoC 및 솔루션의 개발을 진행하여 왔으며, 지난 2012년부터는 Android OS를 기반으로 한 OTT 및 OTT Stick 제품에 당사의 AP제품을 공급하고 있습니다. 또한, CAS 등 Security 솔루션을 내장한 고성능의 스마트 TV 박스용 SoC의 개발을 진행 중으로 동 제품의 개발을 통하여 방송 사업자 시장(이하 Operator Market이라 한다)에 진출을 준비 중에 있습니다. 이에, 전체 STB시장을 기준으로 한 당사의 시장점유율은 아직 미미한 수준이지만 빠르게 성장하고 있는 OTT Box 및 OTT Stick 시장에서 점차 시장점유율을 확대해 나가고 있으며, 2014년도 하반기에 Security 기능이 강화된 고성능 신제품의 출시로 Operator Market에도 진입할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

□ Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등)

자동차용 반도체 시장의 1위 기업은 전체 시장의 11%를 점유하고 있는 프리스케일이며, 인피니온이 10%로 2위를 차지하고 있습니다. 이외에도 ST마이크로가 9%, 르네사스가 7%로 그 뒤를 따르고 있으며 NEC, NXP, 보쉬, TI 등이 경쟁하는 등 다른 반도체 시장과는 달리 절대적인 강자가 없는 시장으로 향후 치열한 경쟁이 예고되고 있습니다.



당사는 2007년 4월부터 국내 완성차업체의 Car Infotainment 제품에 당사의 Audio Processor를 공급한 이후에 계속적으로 적용 모델을 확대하여 국내 완성차 업체의 차량용 Audio 플랫폼에 70% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 지난해부터는 국내외의 주요 Car Infotainment 제조업체에서 양산하는 Display Audio 및 AVN(Audio Video Navigation)에 제품 공급을 확대함으로써 Car Infotainment에서 당사가 차지하는 점유율은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(2) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 영업개황

(가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

최근 디지털 멀티미디어 제품은 동영상 기능과 오디오 기능 그리고 카메라 기능은 물론 GPS 네비게이션, 모바일 TV 등의 기능을 응용한 융합 제품으로 발전되어 가고 있으며, 이러한 발전 방향은 소비자의 견해에 바탕을 둔 자연스러운 진화과정이 되고있습니다. 따라서, 이러한 시장추세의 변화에 발 맞춘 제품개발/출시를 하는 것이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

특히, 최근에는 이들 멀티미디어 제품이 PC급에 준하는 제품으로 변모하면서 전체 시스템을 운용하는 Operating System 및 Application Processor의 성능이 매우 중요해지고 있기 때문에 최신 OS 를 지원하는 고성능의 제품 출시가 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심적인 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.

(나) 회사의 영업개황

1999년 10월 설립된 이래, 당사는 2001년 세계 최초로 MP3 실시간 녹음과 재생이 가능한

제품의 출시, 2003년 USB Host 기능의 내장, WMA, OGG 등의 다양한 Codec과 다양한 외부 저장매체의 지원 기능, 2005년 세계 최초의 플래시 타입 MP3 플레이어에 대한 PlaysForSure 인증 등 시장의 제품 컨셉과 기술에 한 발 앞선 제품과 기술을 선보여 왔으며, 멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 그에 필요한 Total Solution의 공급에 주력해 오고 있습니다.

당사는 2014년도에 Car Infotainment부문에서 제품 매출증가와 더불어 Car Infotainment용 Android Solution 용역 매출을 통하여 전년 대비 지속적인 매출증가세를 실현하였습니다. 그러나, Consumer부문은 중국향 Tablet PC매출 축소 등에 따라서 전년 대비 매출액이 감소하였습니다..

이에 2014년도 매출액은 전년 대비 1.7% 증가한 752억원을 실현하였으며, 영업이익은 무형자산 상각비 감소와 전사적인 비용절감 활동에 힘입은 비용 감소로 손익이 개선되어 전년 대비 흑자전환한 17억원을 실현하였고, 당기순이익 또한 전년 대비 흑자전환한 14억원을 실현하였습니다.

당사는 2015년도에 자동차용 반도체의 매출 실적향상이 계속 이어질 것으로 전망하고 있으며, 신제품의 출시 등에 따라서 STB부문에서도 매출향상이 있을 것으로 기대하고 있습니다.

한편, 당사는 날로 중요해지는 S/W 개발능력의 향상과 개발 프로세스의 안정화를 위하여 CMMI/SP2 등 S/W 품질 향상을 위한 혁신 프로그램을 적극적으로 도입하여 운용 중에 있으며, 우수한 기술인력의 확보와 양성을 위하여 신규 및 기존인력에 대한 교육시스템을 강화하여 지속적인 성장과 발전의 토대가 되는 내부역량을 강화해 나가고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제16(당)기 2014년 12월 31일 현재

제15(전)기 2013년 12월 31일 현재

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		63,304,454,595		60,191,574,193
현금및현금성자산	5,691,123,117		4,776,742,351	

유동금융자산	33,095,555,648		33,114,741,093	
매출채권및기타유동채권	9,582,562,199		6,499,801,315	
당기법인세자산	134,335,030		173,858,830	
재고자산	12,994,726,381		14,909,097,544	
기타유동자산	1,806,152,220		717,333,060	
II.비유동자산		32,167,704,073		30,754,422,135
비유동금융자산	1,619,302,387		579,139	
장기매출채권및기타비유동채권	7,834,427,839		7,477,306,911	
유형자산	3,741,262,058		3,815,428,881	
무형자산	6,135,395,371		6,020,516,799	
관계기업투자주식	10,985,897,948		9,915,406,669	
이연법인세자산	1,642,476,690		3,144,337,885	
기타비유동자산	208,941,780		380,845,851	
자 산 총 계		95,472,158,668		90,945,996,328
부 채				
I.유동부채		12,177,659,634		9,840,445,648
매입채무및기타유동채무	10,340,547,535		8,190,673,622	
당기법인세부채	5,592,451		-	
유동충당부채	1,255,322,781		1,153,000,923	
기타유동부채	576,196,867		496,771,103	
II.비유동부채		14,193,135,535		12,273,276,333
장기매입채무및기타비유동채무	674,047,825		776,637,548	
비유동충당부채	347,101,187		371,318,870	
퇴직급여채무	13,171,986,523		11,125,319,915	
부 채 총 계		26,370,795,169		22,113,721,981
자 본				
I.납입자본		19,397,984,577		19,239,780,656
II.기타자본구성요소		(10,109,270,108)		(10,118,139,657)
III.이익잉여금		59,812,649,030		59,710,633,348
자 본 총 계		69,101,363,499		68,832,274,347
부 채 와 자 본 총 계		95,472,158,668		90,945,996,328

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제16(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제15(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
I.매출	75,272,433,587	74,010,712,184

제품매출	73,062,351,774		73,684,215,158	
용역매출	1,765,778,633		76,856,696	
기타매출	444,303,180		249,640,330	
II.매출원가		56,557,727,570		60,583,609,906
제품매출원가	55,100,277,607		60,394,829,882	
용역매출원가	1,434,901,437		71,532,879	
기타매출원가	22,548,526		117,247,145	
III.매출총이익		18,714,706,017		13,427,102,278
IV.판매비와관리비		17,008,055,754		21,345,567,691
V.영업이익(손실)		1,706,650,263		(7,918,465,413)
기타이익	904,739,657		609,228,973	
기타손실	2,140,124,891		5,550,829,189	
금융수익	1,388,449,812		1,604,201,983	
금융비용	1,000		-	
관계기업투자손익	1,082,622,869		88,156,581	
VI.법인세비용차감전순이익(손실)		2,942,336,710		(11,167,707,065)
VII.법인세비용		1,513,589,480		6,157,122,434
VIII.당기순이익(손실)		1,428,747,230		(17,324,829,499)
IX.기타포괄손익		(1,208,144,779)		300,159,166
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,326,731,548)		267,965,038
확정급여부채의재측정요소	(1,309,854,226)		230,300,498	
관계기업확정급여부채의재측정요소	(16,877,322)		37,664,540	
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		118,586,769		32,194,128
지분법자본변동	11,682,403		32,194,128	
매도가능금융자산평가이익	106,904,366			
X.총포괄이익(손실)		220,602,451		(17,024,670,333)
X I.주당손익				
기본주당손익		160		(1,949)
희석주당손익		160		(1,949)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 15 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 16 기	제 15 기
처분전 이익잉여금	58,812,904,506	58,710,888,824
전기이월이익잉여금	58,710,888,824	75,722,772,115
지분법이익잉여금변동	0	44,981,170
당 기 순 이 익	1,428,747,230	-17,324,829,499
기 타 포 괄 손 익	-1,326,731,548	267,965,038
임의적립금등의 이입액	-	-
합 계	58,812,904,506	58,710,888,824
III. 이익잉여금 처분액	686,167,636	-
현금배당	623,788,760	-
(현금배당 주당배당금(배당율) :	-	-
10%이상 대주주 : 70원(14%)	-	-
소액주주 : 70원(14%)	-	-
이 익 준 비 금	62,378,876	-
차기이월이익잉여금	58,126,736,870	58,710,888,824

- 자본변동표

<자본변동표>

제16(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제15(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과 목	납입자본		기타자본구성요소				이익잉여금	총 계
	자본금	주식발행초과금	기타 자본잉여금	기타포괄 손익누계액	자기주식	기타자본		
당기초 (2013.01.01)	5,304,708,500	13,935,072,156	59,823,250	614,335,677	(10,029,627,695)	(712,542,631)	77,167,001,989	86,338,771,246
당기순이익	-	-	-	-	-	-	(17,324,829,499)	(17,324,829,499)
기타포괄손익	-	-	-	32,194,128	-	-	267,965,038	300,159,166
배당금지급	-	-	-	-	-	-	(444,485,350)	(444,485,350)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(82,322,386)	-	(82,322,386)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	44,981,170	44,981,170
당기말 (2013.12.31)	5,304,708,500	13,935,072,156	59,823,250	646,529,805	(10,029,627,695)	(794,865,017)	59,710,633,348	68,832,274,347
당기초 (2014.01.01)	5,304,708,500	13,935,072,156	59,823,250	646,529,805	(10,029,627,695)	(794,865,017)	59,710,633,348	68,832,274,347
당기순이익	-	-	-	-	-	-	1,428,747,230	1,428,747,230
기타포괄손익	-	-	-	118,586,769	-	-	(1,326,731,548)	(1,208,144,779)
지분의 발행	10,780,500	51,676,620	-	-	-	-	-	62,457,120
주식선택권	-	95,746,801	82,905,000	-	-	(178,651,801)	-	-

배당금지금	-	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(13,970,419)	-	(13,970,419)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말 (2014.12.31)	5,315,489,000	14,082,495,577	142,728,250	765,116,574	(10,029,627,695)	(987,487,237)	59,812,649,030	69,101,363,499

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제16(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제15(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과목	제16(당)기	제15(당)기
1. 영업활동현금흐름	8,442,133,252	2,784,005,707
1. 당기순이익(손실)	1,428,747,230	(17,324,829,499)
2. 당기순이익조정을 위한 가감	6,968,269,771	20,025,773,116
퇴직급여	2,135,817,768	2,060,225,988
감가상각비	833,269,287	985,609,872
외화환산손실	31,727,436	17,813,541
무형자산상각비	5,664,677,171	10,072,886,402
무형자산손상차손	1,018,778,050	4,766,122,182
유형자산처분손실	2,000	9,000
기부금	60,000	216,431
비화폐성급여	29,662,929	33,892,159
비화폐성임차료	202,139,579	202,745,672
관계기업투자손익	(1,082,622,869)	(88,156,581)
외화환산이익	(3,814,231)	(11,551,802)
당기손익인식금융자산처분이익	(32,998,912)	(440,279)
당기손익인식금융자산평가이익	(3,283,036)	-
매도가능금융자산손상차손	1,000	-
매도가능금융자산손상환입	(10,649,521)	-
매도가능금융자산처분이익	(33,180,557)	-
유형자산처분이익	(16,817,181)	(4,180,819)
정부보조금조정	(429,720,289)	(2,139,268,478)
이자수익	(1,308,337,786)	(1,603,761,704)
연구자금정산이익	(149,983,777)	(59,597,773)
매출채권의 감소(증가)	(1,520,114,240)	691,796,329
미수금의 감소(증가)	(1,624,007,742)	288,456,633
선급금의 감소(증가)	(751,404,409)	(144,380,243)
선급비용의 감소(증가)	(256,715,491)	253,171,468
장기선급비용의감소(증가)	(25,183,327)	8,383,320
재고자산의 감소(증가)	1,914,371,163	1,185,779,741
이연법인세자산의 감소(증가)	1,501,861,195	6,205,395,102
매입채무의 증가(감소)	(231,249,740)	(1,391,802,299)

미지급금의 증가(감소)	2,353,423,458		(962,850,267)	
선수금의 증가(감소)	109,046,377		45,738,024	
예수금의 증가(감소)	(29,542,097)		67,230,003	
미지급비용의 증가(감소)	12,162,883		109,328,751	
종업원급여충당부채의 증가(감소)	78,104,175		122,376,465	
퇴직금의 지급	(1,413,345,329)		(637,141,054)	
자본에 가감되는 법인세비용	6,135,834		(48,272,668)	
3. 이자지급		-		-
4. 법인세납부(환급)		(45,116,251)		(83,062,090)
II. 투자활동현금흐름		(10,042,713,422)		(6,747,427,038)
1. 투자활동으로 인한 현금유입		33,762,033,122		36,571,461,787
단기금융상품의 처분	31,500,000,000		34,500,000,000	
당기손익인식금융자산의 처분	55,629,912		532,470	
매도가능금융자산의 처분	689,841,677		-	
단기대여금의 회수	531,854,155		546,895,871	
보증금의 감소	1,167,579		280,000,000	
차량운반구의 처분	16,818,181		4,181,819	
이자수취	966,721,618		1,239,851,627	
2. 투자활동으로 인한 현금유출		(43,804,746,544)		(43,318,888,825)
단기금융상품의 취득	31,500,000,000		31,500,000,000	
당기손익인식금융자산의 취득	522,646,828		-	
매도가능금융자산의 취득	1,500,000,000		-	
장기대여금의 대여	580,000,000		600,000,000	
보증금의 증가	84,326,104		370,000,000	
기계장치의 취득	269,096,447		264,910,610	
차량운반구의 취득	16,094,329		34,671,429	
기구비품의 취득	355,556,209		140,512,026	
산업재산권의 취득	41,969,770		27,384,100	
개발비자산의 취득	7,342,176,524		7,386,320,245	
컴퓨터소프트웨어의 취득	201,717,693		108,334,632	
기타무형자산의 취득	1,391,162,640		2,886,755,783	
III. 재무활동현금흐름		2,559,743,651		3,204,801,930
1. 재무활동으로 인한 현금유입		2,784,559,874		3,934,479,872
장기미지급금의 증가	272,210,277		393,447,988	
정부보조금의 수취	2,449,892,477		3,541,031,884	
주식의 발행	62,457,120		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출		(224,816,223)		(729,677,942)
장기미지급금의 감소	224,816,223		108,802,227	
배당금지급	-		444,485,350	
정부보조금의 반환	-		176,390,365	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,334,439)		(11,317,357)
V. 현금의 증가(감소)		957,829,042		(769,936,758)
VI. 기초의 현금		4,778,225,334		5,548,162,092
VII. 기말의 현금 (주석 5)		5,736,054,376		4,778,225,334

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주, %)

구 분	제 16 기	제 15 기	비 고
당기순이익	1,428,747,230	-17,324,829,499	-
배당금 총액	623,788,760	-	-
발행주식수	10,630,978	10,609,417	-
주당배당금	70	-	-
시가배당율	1.41%	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이장규	1963.03.05	×	본인	이사회
이상곤	1967.08.19	×	없음	이사회
장창희	1969.07.25	×	없음	이사회
Martin Manniche	1967.06.13	○	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이장규	(주)텔레칩스 대표이사	- 연세대학교 전자공학과 석사 - 삼성전자 - 씨앤에스테크놀로지 - 現, (주)텔레칩스 대표이사	-
이상곤	(주)텔레칩스 관리본부장	- 서강대학교 경영학과 - 브릿지증권 - 現, (주)텔레칩스 관리본부장	-
장창희	(주)텔레칩스 SoC2 그룹 장	- 서강대학교 전자공학과 석사 - 삼성 SDI - 現, (주)텔레칩스 SoC2 그룹장	-
Martin Manniche	Greenwave Systems, CEO/President	- Graduated from Lyngby Handelsskole in Denmark - Sigma Designs, Board of Directors - Greenwave Systems, CEO/President	-

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	8억원	10억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	2	2
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.